

EPBOARD 0700HT

Placa epoxi para modelado

APLICACIONES

EPBOARD 0700HT es una placa epoxi para modelado resistente a altas temperaturas, adecuada para fabricar modelos maestros en la producción de moldes de preimpregnados en autoclave. También puede utilizarse en moldes de termoformado al vacío o directamente en moldes de piezas de composite de pequeñas series.

CARACTERÍSTICAS

- Alta estabilidad dimensional
- Buena tenacidad y excelente estabilidad de los bordes
- Resistencia a altas temperaturas
- Baja densidad
- Alta calidad superficial

PROPIEDADES FÍSICAS

Producto	EPBOARD0700HT
Color	Azul oscuro
Densidad	0.72-0.78g/cm3

PROPIEDADES MECÁNICAS

Característica ensayada	Método de ensayo	EPBOARD0700HT
Tg/°C	ISO11357:2002(DSC)	≥150
Dureza (25°C)	ISO868:1985	≥72D
CTE	ISO11359-2:1999	≤49*10-6K-1
Módulo de flexión/MPa	ISO178:2001	≥1800
Resistencia a la flexión/MPa	ISO178:2001	≥38
Resistencia a la compresión/MPa	ISO604:2002	≥53

* Condiciones de curado: los datos anteriores se basan en ensayos después de un poscurado de 65°C 7h + 100°C 1h + 130°C 1h + 160°C 8h.

06-2026 EPBOARD 0700HT Página 1 de 3

INSTRUCCIONES DE PROCESADO:

Pegado de placas:

1. Cortar y preparar los bloques y montarlos en seco.
2. Lijar ambas superficies de la unión con papel de grano 320.
3. Eliminar el polvo con aire comprimido y utilizar un disolvente adecuado, como acetona, para retirar los contaminantes de las superficies que se van a pegar.

4. Dejar que se evapore cualquier resto de disolvente antes del pegado.
5. Aplicar uniformemente unos 600g de adhesivo epoxi sobre ambas superficies con una espátula dentada.
6. Unir las dos superficies con adhesivo fresco y aplicar una presión uniforme hasta que salga adhesivo por la junta. Retirar el exceso y comprobar que el espesor de la junta sea uniforme y no supere 1mm.
7. Mantener las placas en posición con una sujeción ligera o un peso distribuido sobre toda la superficie superior del conjunto, para garantizar una presión uniforme.
8. Esperar siempre el tiempo suficiente para que cure el adhesivo antes de continuar el mecanizado.
9. Se recomienda un poscurado para alcanzar las máximas prestaciones térmicas del sistema. Enfriar la pieza hasta temperatura ambiente dentro del autoclave, a una velocidad no superior a 20°C por hora. Así se evita un choque térmico en la placa y el adhesivo, que podría provocar una mala unión y fisuras por tensión en la placa.

Soporte:

La placa de utillaje debe contar con un soporte suficiente para evitar tensiones excesivas debidas a su peso. En modelos grandes, se recomienda un bastidor de acero para minimizar la flexión y facilitar la manipulación. Utilizar uno de los adhesivos recomendados para fijar el soporte posterior o el bastidor a la placa. Tener especial cuidado con las fijaciones mecánicas en placas para alta temperatura: las diferencias entre coeficientes de dilatación térmica pueden provocar alabeo o microfisuras durante el calentamiento y enfriamiento.

DIMENSIONES DE PLACA DISPONIBLES

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN:

Procesar en un lugar bien ventilado y evitar el contacto con la piel durante el mecanizado. Utilizar guantes, mascarilla, gafas de seguridad y ropa de protección. Para más información, consultar la ficha de datos de seguridad.

06-2026 EPBOARD 0700HT Página 2 de 3

NOTA:

Los datos anteriores se han medido en condiciones específicas. Los procedimientos y condiciones de procesado pueden variar en las aplicaciones reales; por ello, realizar los ensayos necesarios antes de utilizar el producto y confirmar que cumple los requisitos de la aplicación. EPTEK garantiza que sus productos cumplen sus normas más exigentes de gestión de calidad.

06-2026 EPBOARD 0700HT Página 3 de 3